

●半導体製造装置

パソコン、携帯電話など、デジタル製品の基幹部品である半導体デバイス(ICチップ)。その生産を担う半導体製造装置を幅広く取り揃え、優れた技術サポートとともに提供しています。

ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、プラズマエッチング装置、熱処理成膜装置、枚葉成膜装置、洗浄装置、そして、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバの6製品群をラインアップ。製品の多くが世界市場でトップシェアを獲得しています。

主要取扱い製品

- コータ/デベロッパ
- プラズマエッチング装置
層間絶縁膜エッチング装置・シリコンエッチング装置
- 熱処理成膜装置
- 枚葉成膜装置
CVD装置・プラズマ処理装置
- 洗浄装置
オートウェットステーション・枚葉洗浄装置
ブリクレーン装置・スクラパーシステム
- ウェーハプローバ



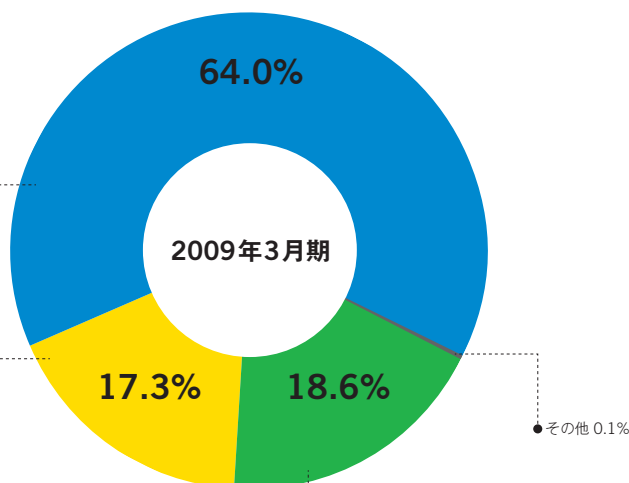
コータ/デベロッパ
CLEAN TRACK® LITHIUS Pro® V



熱処理成膜装置
TELINDY PLUS®



枚葉洗浄装置
CELLESTA®+



●FPD/PV製造装置

美しく鮮やかな映像を映し出すパソコンや液晶テレビのディスプレイ。その生産を担うFPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置を、確かな技術サポートとともに提供しています。製品ラインアップは、FPDコータ/デベロッパとプラズマエッチング/アッシング装置。大型液晶テレビの普及に伴い、装置の基板サイズも年々大型化しています。

地球環境にやさしいクリーンエネルギーとして注目を浴びる太陽電池。2008年、当社の事業領域に新しく太陽電池(PV)製造装置分野が加わりました。

主要取扱い製品

- FPDコータ/デベロッパ
- FPDプラズマエッチング/アッシング装置
- 薄膜Si太陽電池用プラズマCVD装置
- 薄膜Si太陽電池用一貫製造ライン(エリコンソーラー社のアジア・オセアニア地域における独占販売代理店として)



FPDプラズマエッチング/アッシング装置
Impressio®

●電子部品・情報通信機器

世界の優れた電子部品、コンピュータ・ネットワーク機器等を多彩に取り揃え、販売を行う「商社ビジネス」と、お客様のニーズに応じて設計開発や自社ブランド商品の開発を行う「開発ビジネス」の二つの機能を有する、新しい形態のビジネスを展開しています。東京エレクトロンデバイス株式会社が当ビジネスのオペレーションを行います。

主要取扱い製品

- 半導体製品
- 電子部品他
- ソフトウェア
- コンピュータ・ネットワーク機器



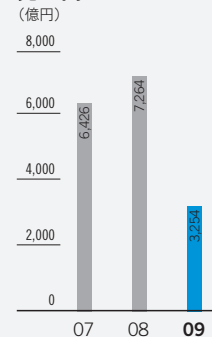
東京エレクトロンデバイス(株)開発の
inrevium®

半導体製造装置

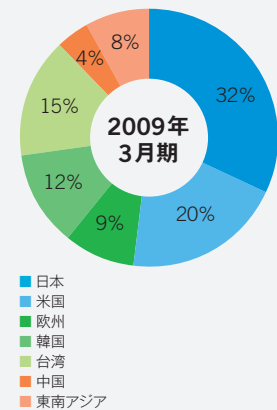
2009年3月期概要

- 事業環境：メモリ製品の市況の悪化に加え、期後半からの世界同時不況の影響で、半導体製品全体に対する需要が大幅に減少。半導体メーカーの設備投資に急ブレーキがかかった
- 売上高：前期比55.2%減少の3,254億円
- 全地域減収となったが、メモリ顧客の多いアジアでの減収が著しく、特に台湾向け売上が前期比80.7%と大幅に減少した
- 受注は、期後半から急減し、年間受注高は前期比57.4%減少の2,145億円となった

売上高



地域別売上構成比

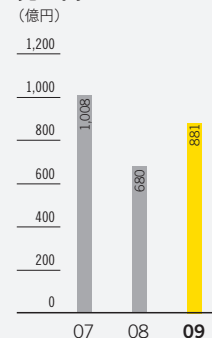


FPD/PV製造装置

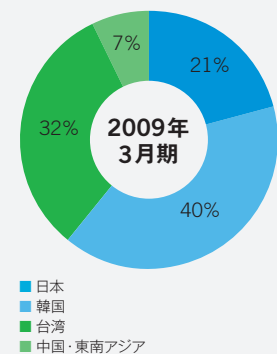
2009年3月期概要

- 事業環境：大型テレビ用液晶パネル向けの設備投資が堅調に進んだ。しかし、期後半には世界経済の悪化でパネル市況が崩れ、パネルメーカーの投資意欲に再びかげりが見えた
- 売上高：前期比29.5%増加の881億円
- 韓国において前期比97.3%、台湾において88.3%の増収となった
- 第7世代、第8世代のガラス基板に対応する装置が売上のほぼ半分を占めた。さらに大型の第10世代の装置出荷も始まった
- 受注は、期後半から急減し、年間受注高は前期比53.4%減少の606億円となった

売上高



地域別売上構成比

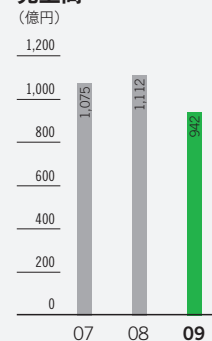


電子部品・情報通信機器

2009年3月期概要

- 事業環境：エレクトロニクス製品に対する需要後退に加え、企業業績悪化と景気の先行きに対する不安から新規のIT投資等を抑制する傾向が期後半から顕著になった
- 売上高：前期比15.3%減少の942億円
- 売上の77%を占める半導体および電子デバイス分野では、自社ブランド「inrevium (インレビウム)」の開発ビジネスおよび重点戦略マーケットである産業機器分野の強化に努めた

売上高



地域別売上構成比

